

/ Descriptions

MM E 3 3 0 Z 1

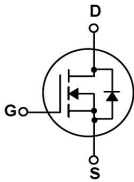
/ Features

H 3 U/H r i 3 k/Ä H 3 y ð

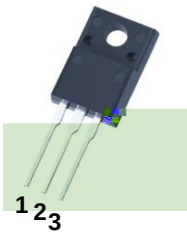
/ Applications

Ä 3 3 3 I ' GF2GF 3 "Ω 3 I ' Ä H

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

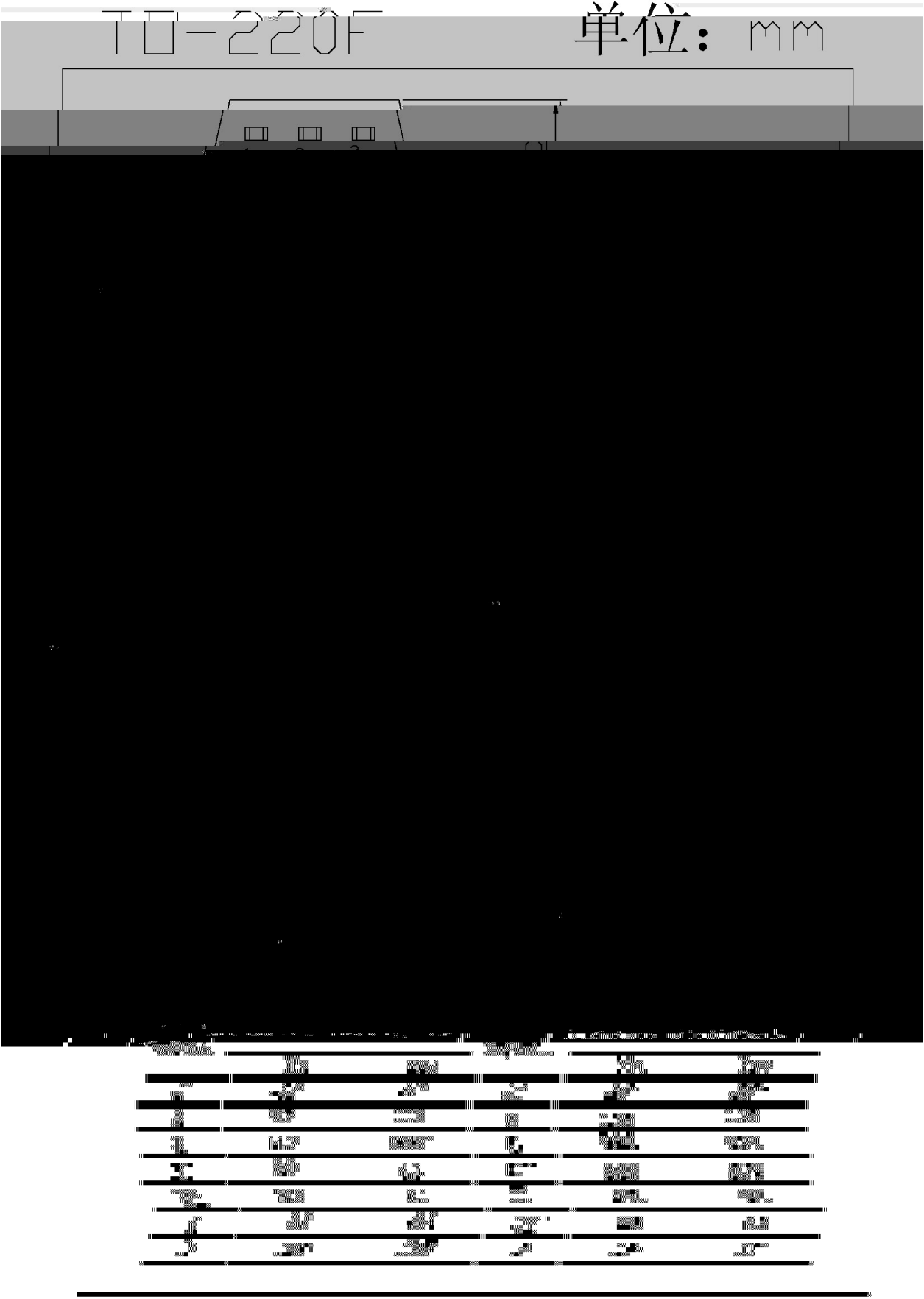
/ hFE Classifications & Marking

3 M 3 3 "

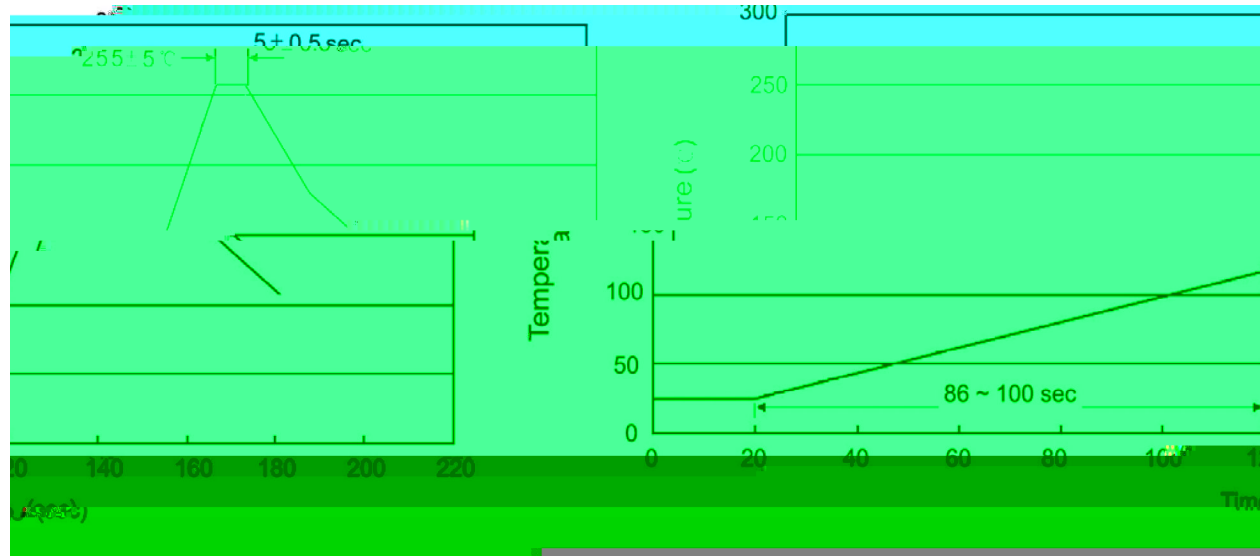
Ƶ "Œ	Ÿ N	"Œ Œ	D Œ
------	-----	------	-----

/ Electrical Characteristic Curve

/ Package Dimensions



() / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



1. 焊接温度：220±5℃，时间：5±0.5秒。
2. 预热温度：100℃，时间：86~100秒。
3. 焊接后，元件应自然冷却，不可用水或其他液体冷却。

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

1. 元件应能承受规定的焊接热应力。
2. 焊接后，元件应无裂纹、变形等缺陷。

/ Packaging SPEC.

1. 包装形式：

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只袋	袋盒	只盒	盒箱	只箱	袋	盒	箱

2. 包装尺寸：

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只套管	套管盒	只盒	盒箱	只箱	套管	盒	箱

/ Notices